



Elephantech

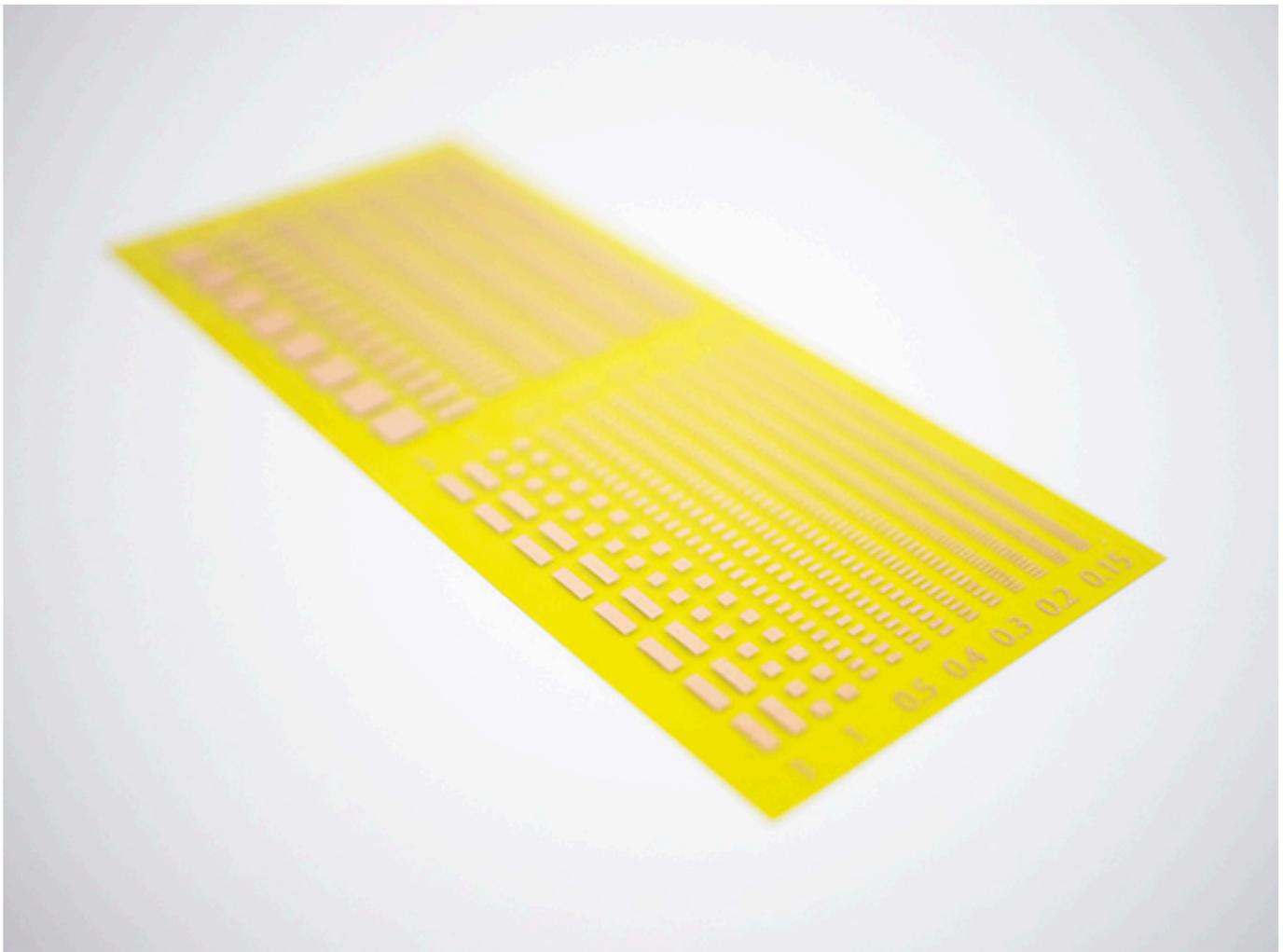
ポリイミドP-Flex®開発品展示のお知らせ

2018年4月11日

プリントド・エレクトロニクス技術で完全な型レス・ローコストのFPC「P-Flex®」製造を展開するエレファンテック株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：清水信哉、以下「エレファンテック」）は、4月13日から4月16日まで開催されるHong Kong Electronics Fair Spring Edition 2018にて、ベースフィルムを従来のP-Flex®で対応していたPETではなくポリイミドとした、ポリイミドP-Flex®の開発品を展示します。

エレファンテックでは、プリントド・エレクトロニクス技術による完全な型レス・ローコストのFPC「P-Flex®」を展開してきました。P-Flex®は従来のFPC（フレキシブル基板）に比べて量産コストを削減するだけでなく、型費用がゼロになることから、多品種少量化・マスカスタマイゼーションの進む世界に合致した製造方法として、年間数万台程度の中小ロット量産のお客様から特に好評を得て、販売拡大を行ってきました。しかしながら、これまでP-Flex®ではベースフィルムがFPCで一般的に用いられるポリイミドではなく、耐熱性に劣るPETのみでの提供になるという課題がありました。これは、印刷技術によって形成した金属配線をベースフィルムと十分に密着させることがPETでしかできていなかったためでしたが、このたび、特殊な金属インク、特殊なフィルム表面加工、その他プロセスの最適化により、ポリイミドへの密着が可能となりました。現状ではまだ発売時期は未定で、今回は開発品としての展示となります。

エレファンテックは今後も、従来のFPCに比べて工程数は2分の1、廃液量は10分の1以下と、コストも低く環境にも優しいこの製造方法をグローバルスタンダードとするため活動していきます。



Hong Kong Electronics Fair Spring Edition 2018

<http://event.hktdc.com/fair/hkelectronicfairese-en/HKTDC-Hong-Kong-Electronics-Fair-Spring-Edition/>

期間：2018/4/13 (Fri) -2018/4/16 (Mon)

時間：09:30 - 18:30 (最終日のみ17:00までとなります)

会場：Hong Kong Convention and Exhibition Centre (ブース：3CON-A20)

会社概要

名称	エレファンテック株式会社
代表	代表取締役 清水信哉
設立	2014年1月 (2017年9月4日にAgIC株式会社から商号変更)
資本金	4億5839万円 (資本準備金を含む)
所在地	104-0032 東京都中央区八丁堀四丁目3番8号
URL	https://www.elephantech.co.jp
主な事業内容	プリントド・エレクトロニクス製造技術の開発、製造サービス提供

2018年4月11日現在

本件に関するお問い合わせ先

エレファンテック株式会社 広報担当

メールアドレス：contact@elephantech.co.jp